

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司
2026 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年七月

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国科微”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金，编制了向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南国科微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

一、本次发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 506,117.59 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目	98,999.38	65,877.40
2	媒体交互 AI 芯片研发及产业化项目	171,790.59	163,967.18
3	端侧 AI 芯片研发及产业化项目	158,210.04	146,273.01
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
合计		559,000.00	506,117.59

在本次发行的董事会审议通过之后至本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目

1、项目概况

项目名称：新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目

项目实施地点：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号

项目实施主体：湖南国科微电子股份有限公司

项目建设内容：本项目为新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案项目的研发与产业化项目，主要面向智能视觉领域，研发覆盖专业安防、消费类视觉终端、智能家居、智慧交通、车载视觉、边缘智能设备等应用场景，提供新一代 AI 视觉处理芯片及完整解决方案

项目总投资：98,999.38 万元

拟使用募集资金额：65,877.40 万元

项目建设期：36 个月

2、项目投资概算

本项目总投资为 98,999.38 万元，拟使用募集资金投入 65,877.40 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	1.1 硬件设备购置费	3,046.60	3,046.60
	1.2 软件工具购置费	372.00	372.00
	1.3 IPCore 及 EDA	5,640.00	5,640.00
	1.4 流片试制费用	18,910.00	18,910.00
	1.5 封装测试费用	3,800.00	3,800.00
2	2.1 研发人员工资	39,608.80	34,108.80
	2.2 其他人员工资	10,898.31	-
3	预备费	2,468.27	-
4	铺底流动资金	14,255.40	-
合计		98,999.38	65,877.40

3、项目必要性

(1) AI 视觉应用场景快速扩张，对芯片综合性能提出更高要求

人工智能技术正加速从云端向边缘侧和端侧下沉，智能视觉作为 AI 最重要的感知入口之一，其应用边界正在被大幅拓宽。传统的专业安防监控仅是视觉芯片的起点，消费类视觉终端、智能家居、智慧交通、车载视觉、边缘智能设备等新兴场景正在密集释放需求。在车载领域，智能驾驶渗透率的提升带动单车摄像头数量持续增长，对视觉芯片的实时处理能力、低延时响应和严苛环境下的可靠性提出了极高要求；在消费端，人脸识别、手势交互、行为分析等功能逐步成为各类终端的标配，要求视觉芯片在有限功耗约束下提供充分的 AI 推理能力；在智慧交通和边缘计算场景中，路侧单元和边缘节点需要在带宽受限的条件下完成本地化的视觉分析和结构化处理。上述场景对芯片的需求已不再是单一的编解码或图像信号处理，而是要求芯片能够同时完成图像采集、画质优化、智能分析、编码传输乃至系统级调度等一系列复杂任务，这对芯片的算力密度、功耗控制和接口丰富度构成了全方位的挑战。

（2）高端 AI 视觉芯片对外依赖度较高，自主突破势在必行

在 AI 视觉处理芯片这一细分领域，高端产品的全球供应链仍高度集中于少数几家国际芯片厂商手中。国内芯片设计企业虽然在部分中低端视频编解码芯片市场取得了突破，但在同时具备高性能神经网络加速引擎、先进图像信号处理单元和低功耗异构计算架构的高端 SoC 芯片方面，产品布局和技术积累仍存在明显不足。近年来，全球集成电路产业链的不确定性持续上升，供应链扰动等因素使得关键芯片的获取渠道面临变数。智能视觉芯片作为智慧城市、智能交通、公共安防等国家关键基础设施的核心元器件，其供应链的安全性直接关系到上述领域的稳定运行，加快推进自主 AI 视觉处理芯片的研发与产业化，降低渠道依赖。

（3）行业技术迭代加速，产品向智能化方向升级是大势所趋

从技术演进路径来看，视觉处理芯片正经历从“看得清”到“看得懂”的深刻转变。早期视频芯片的核心竞争力主要体现在分辨率支持、编码效率和功耗等基础指标上，而当前下游应用对芯片的要求已经延伸到场景理解、目标识别、行为分析等智能化层面，传统依赖云端卸载的 AI 推理模式正逐步被端侧和边缘侧计算所取代。因此，新一代视觉芯片必须将神经网络处理能力作为核心功能模块进行深度整合，而非进行浅层叠加。与此同时，低功耗系统架构设计

技术的进步也为端侧 AI 计算提供了更加务实的技术路径。在这种技术趋势下，率先推出兼具高性能和低功耗 AI 视觉 SoC 方案的企业，则有望在新的竞争格局中占据有利位置。

4、项目可行性

（1）国家产业政策持续加码，为项目提供明确政策支撑

集成电路产业和人工智能技术是国家中长期科技发展的重点方向，近年来从中央到地方密集出台了一系列支持政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将集成电路列为关键核心技术攻关的重中之重，明确提出要在芯片设计、制造工艺等环节实现突破性进展。在人工智能领域，相关政策文件持续强调推动 AI 技术与各行业的深度融合，智能视觉作为 AI 最有落地价值的细分方向之一，与国家政策鼓励的“人工智能+”行动和集成电路自主可控方向高度契合。政策的持续引导不仅为本项目提供了宏观层面的合规性保障，也意味着在人才引进、研发支持、产业对接等方面能够得到良好的外部环境支撑，降低了项目实施的政策不确定性。

（2）多应用场景协同增长，下游市场空间广阔且可持续

AI 视觉处理芯片的下游需求正在经历从单一场景到多元场景的同步扩张。专业安防领域持续推进的数字化和智能化升级带来存量设备的更新换代需求；消费类视觉终端在智能门锁、可视门铃、扫地机器人等产品中的渗透率稳步提升；智能家居场景下带视觉能力的交互设备品类不断丰富；智慧交通领域对路侧视觉感知节点的部署力度持续加大；车载视觉受益于智能驾驶等级的提升，单车搭载的视觉芯片数量和价值量同步攀升。上述各细分赛道并非此消彼长的存量博弈，而是处于不同的增长阶段、释放出叠加性的市场需求。与此同时，终端设备厂商对芯片成本和功耗的敏感度持续上升，高性价比、低功耗的国产 AI 视觉芯片方案更加契合整机厂商的产品定义需求，在市场导入环节具备天然的适配优势。广阔且层次丰富的市场空间为项目产品提供了充足的消化渠道。

（3）成熟技术体系与扎实人才储备，为本项目实施提供坚实保障

公司深耕视觉芯片领域，在 ISP 图像处理、VENC 视频编解码、NPU 视频智能分析、低功耗等核心技术上持续投入，丰富产品矩阵，相继推出高端 4K

AI 智慧视觉系列产品，持续助力客户快速实现场景落地。本项目研发所涉及的图像处理技术、高性能视频处理技术、自主神经网络处理技术以及低功耗系统架构设计技术等内容，与公司现有的技术体系具有较强的延续性和协同性，并非从零开始的探索性研发，而是在既有技术基础上的系统性升级和深度拓展。同时公司拥有一支经验丰富、创新能力强、行业技术领先的研发团队，能够准确把握行业发展动态并积极开发新技术和新产品。成熟的技术体系和扎实的人才储备为本项目的顺利实施提供了强有力的保障。

5、项目效益情况

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目建成达产后，预计将为公司带来持续的利润增量，进一步增厚公司整体盈利水平，增强公司在行业中的竞争优势。

6、项目涉及的有关报批事项

截至本预案公告日，公司尚未完成项目立项备案程序。公司本次募集资金投资项目围绕公司集成电路设计领域展开，募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律法规和规章的规定。

公司本募集资金投资项目不涉及生产制造环节，募集资金投资项目符合国家环境保护政策，不涉及房屋土建或产品生产线的建设，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所列应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，无需进行环境影响评价审批。

（二）媒体交互 AI 芯片研发及产业化项目

1、项目概况

项目名称：媒体交互 AI 芯片研发及产业化项目

项目实施地点：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号

项目实施主体：湖南国科微电子股份有限公司

项目建设内容：本项目为 AI 媒体交互芯片及解决方案研发与产业化项目，聚焦端侧 AI 与具身智能场景核心需求，开展新一代大算力神经网络处理单元（NPU）、高性能视频编解码器、新一代图像信号处理（ISP）引擎等核心技术

攻关，迭代开发覆盖从入门到旗舰的 AI 媒体交互芯片产品

项目总投资：171,790.59 万元

拟使用募集资金额：163,967.18 万元

项目建设期：36 个月

2、项目投资概算

本项目总投资为 171,790.59 万元，拟使用募集资金投入 163,967.18 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	1.1 硬件设备购置费	20,300.00	20,300.00
	1.2 软件工具购置费	900.00	900.00
	1.3 IP Core 及 EDA	39,430.00	39,430.00
	1.4 流片试制费用	31,060.76	31,060.76
	1.5 封装测试费用	6,900.00	6,900.00
	1.6 委外技术服务费和认证费	7,000.00	7,000.00
2	2.1 研发人员工资	58,376.42	58,376.42
	2.2 其他人员工资	2,644.83	-
3	预备费	4788.36	-
4	铺底流动资金	390.22	-
合计		171,790.59	163,967.18

3、项目必要性

(1) 响应国家集成电路与人工智能产业战略，助力核心技术自主可控

集成电路是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力。国家先后出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）》等一系列政策文件，明确提出要加快高端芯片等核心技术攻关，提升人工智能芯片等关键硬件的供给能力，推动核心技术自主可控，保障产业链供应链安全。媒体 AI 交互芯片是智能终端设备的核心元器件，广泛应用于消费

电子、商用显示、工业控制、智能机器人等多个领域，是端侧 AI 落地的核心硬件载体。本项目研发的 AI 媒体交互芯片，聚焦核心技术自主研发，突破大算力 NPU、超高清编解码、高端 ISP 等关键技术，实现核心 IP 的自主可控，符合国家产业战略发展方向，有助于提升我国在高端媒体芯片领域的自主供给能力，补齐产业链短板。

（2）顺应端侧 AI 与具身智能产业趋势，把握媒体交互 AI 芯片升级机遇

随着以 LLM 为代表的大模型技术快速迭代，人工智能正从云端向端侧加速延伸，物理人工智能（Physical AI）已成为端侧 AI 落地的主流范式。智能设备不再仅具备信息交互功能，更需具备端侧智能决策与物理交互能力，承担实际生产劳动任务，这对终端芯片的 AI 算力、实时性、媒体交互能力提出了全新要求。同时，受通信延迟、数据安全、部署成本等客观因素限制，端侧本地推理已成为智能设备的核心发展方向，具备强 AI 算力的媒体交互芯片成为下一代智能终端的标配，行业面临全面的技术迭代与产品升级。本项目针对端侧 AI 与具身智能场景核心需求，开发覆盖不同性能层级的 AI 媒体交互芯片产品，适配大模型端侧部署需求，顺应产业技术升级趋势，有助于公司把握行业发展机遇，抢占下一代媒体 AI 交互芯片的市场先机。

（3）完善公司产品矩阵，拓展下游应用场景，提升市场竞争力

公司长期深耕媒体芯片领域，已形成具备一定市场竞争力的产品体系，但现有产品在 AI 算力上限、性能层级覆盖密度、高端场景适配能力等方面仍有提升空间，难以全面满足快速增长的端侧 AI 差异化市场需求。本项目开发从入门级 4K 基本型到旗舰级 8K 型的全系列 AI 媒体交互芯片产品，覆盖不同算力、不同价位、不同场景的细分市场需求，能够有效完善公司产品矩阵，丰富产品供给层级；同时产品可广泛应用于 HMI 智能仪表、家居智能中控、智能零售、商用面板、AI Agent 一体机、AIPC、数字员工、具身智能等多个下游领域，大幅拓展公司下游应用场景边界，提升公司在 AI 媒体交互芯片领域的市场竞争力与行业地位。

4、项目可行性

（1）深厚的技术积累与成熟的研发体系为项目提供坚实支撑

公司长期深耕媒体芯片领域，坚持核心技术自主研发路线，已形成深厚的技术积累与成熟的研发体系，为本项目的顺利实施提供了坚实的技术保障。一是核心技术具备扎实的商用基础。公司自研 NPU 已演进至第四代，具备成熟的技术落地经验；视频编解码、ISP 等核心技术已在多款量产产品中实现商用，经过市场充分验证；针对本项目涉及的数据流架构 NPU、新一代 ISP 等技术方向，公司已开展前期技术预研，具备相应的技术储备。二是核心技术自主可控。本项目涉及的核心技术为公司自主研发，公司掌握核心技术的知识产权，能够根据市场需求灵活进行技术迭代与产品优化，保障产品的技术自主性与供应链安全。三是具备完整的研发流程体系。公司规划了覆盖 IP 技术研发、芯片项目开发、方案项目开发的全流程研发管理体系。IP 技术项目流程覆盖从原始需求与设计到片上系统（SoC）项目交付客户的全链条活动；芯片项目开发流程可实现 IP 技术储备与产品规划的高效衔接；方案项目开发流程可保障软件版本迭代与客户二次开发支持。成熟的研发体系能够保障项目按计划高效推进。综上，公司具备实施本项目所需的核心技术能力与研发体系支撑，项目技术可行性充分。

（2）广阔的下游市场空间与清晰的推广路径保障项目实施

本项目产品下游应用场景广阔，市场需求持续增长，同时公司具备成熟的市场推广体系与客户基础，能够保障项目产品的顺利落地。一是下游市场空间广阔。随着数字经济与人工智能产业的快速发展，HMI 智能仪表、智能家居、商用显示、AI 终端、具身智能等下游领域持续增长，对具备 AI 算力的媒体交互芯片需求持续提升，市场规模不断扩大，为本项目产品提供了充足的市场空间。二是公司具备扎实的客户基础。公司在媒体芯片领域深耕多年，积累了丰富的客户资源，与下游多个领域的头部企业建立了稳定的合作关系，能够为项目产品的市场导入提供客户基础，降低市场拓展风险。三是市场推广路径清晰可行。公司规划了分阶段的市场推广策略，通过筛选行业影响力强、研发实力突出的 α 客户，验证产品技术可行性，打造标杆案例，逐步向重点客户与行业头部客户复制推广，建立稳定出货基本盘与规模化量产。清晰的推广路径能够保障产品市场拓展的有序推进，实现项目预期效益。

5、项目效益情况

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目建成达产后，预计将为公司带来持续的利润增量，进一步增厚公司整体盈利水平，增强公司在行业中的竞争优势。

6、项目涉及的有关报批事项

截至本预案公告日，公司尚未完成项目立项备案程序。公司本次募集资金投资项目围绕公司集成电路设计领域展开，募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律法规和规章的规定。

公司本募集资金投资项目不涉及生产制造环节，募集资金投资项目符合国家环境保护政策，不涉及房屋土建或产品生产线的建设，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所列应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，无需进行环境影响评价审批。

（三）端侧 AI 芯片研发及产业化项目

1、项目概况

项目名称：端侧 AI 芯片研发及产业化项目

项目实施地点：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号

项目实施主体：湖南国科微电子股份有限公司

项目建设内容：本项目为全系列端侧 AI 芯片及解决方案项目，围绕新一代数据流架构 NPU、AI-ISP 图像处理引擎以及 Chiplet 多芯互联三大核心技术，规划系列化芯片

项目总投资：158,210.04 万元

拟使用募集资金额：146,273.01 万元

项目建设期：36 个月

2、项目投资概算

本项目总投资为 158,210.04 万元，拟使用募集资金投入 146,273.01 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	1.1 硬件设备购置费	25,050.00	25,050.00
	1.2 软件工具购置费	900.00	900.00
	1.3 IP Core 及 EDA	34,880.00	34,880.00
	1.4 流片试制费用	31,960.76	31,960.76
	1.5 封装测试费用	6,900.00	6,900.00
	1.6 委外技术服务费和认证费	5,500.00	5,500.00
2	2.1 研发人员工资	41,082.25	41,082.25
	2.2 其他人员工资	2,891.70	-
3	预备费	4,474.94	-
4	铺底流动资金	4,570.39	-
合计		158,210.04	146,273.01

3、项目必要性

（1）抢占国家算力基础战略高地

当前，全球主要经济体已将人工智能芯片视为决定未来科技竞争力的核心战略资源。我国“十五五”规划、“人工智能+”行动以及集成电路产业扶持政策均明确鼓励发展面向智能终端、机器人、工业互联网等场景的边缘与端侧 AI 计算芯片。该项目可帮助企业在国家算力基础设施布局中占据有利位置，获取政策资金、税收优惠及市场准入等多重支持。同时，随着下游客户对供应链自主可控要求的持续提升，具备自主研发能力的端侧 AI 芯片项目，将在关键基础设施等领域获得“安全溢价”。因此，该项目不仅顺应国家战略方向，更是企业巩固行业地位、获取长期政策红利的战略支点。

（2）消费与工业端 AI 需求井喷提供确定性的市场增量空间

从消费端看，全球扫地机器人、割草机器人、泳池机器人等清洁类智能设备年销量已突破千万台级别，且正经历从传统 MCU 控制向 AI 视觉导航、自主决策的换代升级，每台设备需要 1-16 TOPS 的 AI 算力，芯片需求呈指数级增长。从工业端看，制造业数字化转型深入推进，自动叉车、自主移动机器人、智能机械臂等设备对 AI 芯片的需求从单一传感向实时环境感知、路径规划、人机协作升级，且对芯片的工业级可靠性要求更高。此外，无人机、AI 眼镜、智能学

习机等新兴品类也在快速渗透。细分市场共同构成了从低功耗到高算力的完整需求光谱，可使企业在市场爆发前期完成产品布局，建立先发优势，抢占市场份额。

（3）大模型向端侧迁移带来的架构性挑战重新定义 AI 处理器

以 Transformer 为代表的大模型技术正在从云端向端侧快速迁移，然而传统 NPU 多针对卷积神经网络优化，在大模型推理中面临内存带宽不足、注意力计算效率低下、功耗偏高等系统性难题，行业迫切需要原生支持大模型架构的 AI 处理器，通过优化矩阵乘法、支持稀疏计算、引入可重构计算等创新设计，实现更高能效比。该项目可以集中资源突破上述核心技术，形成自主可控的高算力 AI SoC 设计能力，并围绕芯片构建配套的工具链、编译器及模型优化平台，提升企业在端侧 AI 芯片市场中的议价能力和持续盈利能力。

4、项目可行性

（1）核心技术积累与梯次研发路径奠定坚实的工程基础

在技术层面，公司拥有扎实的核心技术积累和清晰的研发路径，确保项目顺利推进。NPU 方面，公司自研 NPU 已演进至第四代，已具备从控制流架构向数据流架构演进的技术基础，可专门针对 VLM、VLA 等大模型进行优化。ISP 方面，“圆鹖” AI-ISP 技术已在智慧视觉产品线中得到验证，降噪、多光谱融合、防抖拼接等能力可直接迁移至机器人场景。基本型芯片基于已成功商用的产品迭代升级，技术继承性强，研发风险可控。

（2）分阶段导入策略叠加客户资源缩短市场验证周期并降低推广风险

在市场层面，项目规划了从 α 客户导入到重点客户推广再到大面积量产的三阶段推广策略，可有效利用现有客户资源实现快速市场导入。项目规划了从 α 客户导入到重点客户推广再到大面积量产的三阶段推广策略，可有效利用公司在智慧视觉和超高清显示领域积累的现有客户资源。产品覆盖家用清洁机器人、商用机器人、工业机器人、工业 PLC、智能交通、边缘 AI 等广阔场景，市场需求确定性强且增长潜力巨大。 α 客户从现有客户资源中筛选，可有效缩短市场验证周期，降低市场导入风险。

（3）Fabless 模式与关键 IP 自主可控在国产化生态协同中占据天然优势

在供应链和生态层面，公司 Fabless 模式成熟稳定，关键 IP 自主可控，国产化生态协同优势明显。公司长期采用 Fabless 模式运营，与主流晶圆代工厂、封装测试厂建立了稳定合作关系，供应链整体安全可控。同时，公司已深度融入鸿蒙生态，芯片可适配国产操作系统，下游应用适配空间广阔。

5、项目效益情况

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目建成达产后，预计将为公司带来持续的利润增量，进一步增厚公司整体盈利水平，增强公司在行业中的竞争优势。

6、项目涉及的有关报批事项

截至本预案公告日，公司尚未完成项目立项备案程序。公司本次募集资金投资项目围绕公司集成电路设计领域展开，募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律法规和规章的规定。

公司本募集资金投资项目不涉及生产制造环节，募集资金投资项目符合国家环境保护政策，不涉及房屋土建或产品生产线的建设，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所列应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，无需进行环境影响评价审批。

（四）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的 130,000.00 万元用于补充流动资金，以更好地满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，增强综合竞争力。

1、项目必要性

集成电路行业需持续研发资金投入。伴随公司经营规模持续扩大，流动资金需求不断增加。近年集成电路行业上游材料价格存在波动，加大了企业资金周转压力。本次补充流动资金可有效覆盖日常经营与研发开支，提升企业生产经营连续性，适配公司业务扩张发展节奏。

截至 2026 年 3 月末，公司资产负债率为 44.26%。本次募集资金用于补充流动资金，可有效降低公司负债规模，优化资本结构，压降财务费用。同时能够提升货币资金储备，增强公司现金流抗风险能力，应对上游材料价格波动等

不确定风险，保障企业长期稳健经营。

2、项目可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业，且本次募投项目非资本性支出超过募集资金总额30%的部分将用于主营业务相关的研发投入，因此，本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准（2026年修订）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金将运用于新一代AI视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目、媒体交互AI芯片研发及产业化项目、端侧AI芯片研发及产业化项目及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，将完善公司的产品布局，提升公司相关产品的市场竞争力，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供持续动力，同时有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力和整体竞争力。因此，本次向特定对象发行对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将同步提升，资金实力得到显著增强。一方面，公司资产负债率将有所下降，财务结构更趋稳健，抗风险能力与后续间接融资能力进一步提升；另一方面，募集资金用于补充流动资金，可有效缓解公司业务扩张与研发投入带来的营运资金压力，降低公司对债务融资的依赖，减少财务费用支出，提升整体盈利水平。

从长期来看，随着募投项目逐步达产并释放效益，公司营业收入与利润规模将稳步增长，持续盈利能力不断增强。受募投项目建设周期与效益释放节奏影响，短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能存在一定程度的摊薄，公司将通过提升资金使用效率、加快项目落地进度等方式，切实保障投资者利益。

四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目均围绕公司集成电路设计核心主业布局，紧密契合公司中长期技术与产品发展战略，是对现有业务体系的升级、延伸与支撑，与公司现有技术积累、产品矩阵、客户资源高度协同，不存在偏离主营业务的情形。公司现有核心产品覆盖智慧视觉、超高清视频处理等领域，已形成成熟的芯片研发与产业化体系。本次募集资金投资项目在公司现有视频编解码、图像信号处理等技术基础上，集成高性能端侧 AI 算力引擎，面向智慧视觉、智能车载、智能终端等场景开发高集成度 AI 融合芯片，是对现有产品线的价值延伸与性能升级，实现公司在 AI 芯片领域从“视觉感知”到“媒体交互”再到“智能行动”的完整技术路线和产品图谱，将进一步拓宽产品应用边界，提升产品附加值，巩固公司在端侧视觉处理芯片领域的竞争地位，保障公司技术路线持续紧跟行业先进水平。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司深耕集成电路设计行业多年，建立了完整的芯片研发与产业化团队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 660 人，占公司员工总数的 77.74%，核心技术人员稳定；公司分别于 2019 年、2021 年及 2025 年陆续推出限制性股票激励计划，搭建中长期激励机制，稳固核心人才梯队。未来，公司将持续推进人力资源的整体优化，为公司在本次发行完成后的持续发展提供强有力的人才保障。

2、技术储备

公司自设立以来坚持高强度研发投入，2025 年度研发投入为 73,872.75 万元，占营业收入的比例为 41.24%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司累计获得授权的国内专利证书 415 件（其中发明专利 385 件），计算机软件著作权登记证书 214 件，集成电路布图设计登记证书 72 件。公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新，相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC 芯片、MCU 芯片、电源管理芯片、汽车功能安全、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、自研 NPU、无线局域网、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域构筑自主核心技术，基于核心技术的突破，形成较为完整的自主技术体系和产业化体系，保障产品迭代演进。

3、市场储备

公司深耕集成电路设计领域多年，在超高清智能显示、智慧视觉、车载电子、人工智能、物联网等细分市场积累了丰富的渠道资源和客户基础，为本次募投项目的市场推广和产业化落地提供了有力支撑。

在智慧视觉领域，公司智慧视觉系列芯片可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、智慧楼宇、社区、智慧行车、智慧农场、智能家居等场景，公司是目前市面少数在专业安防和消费类 IPC 产品双线布局的企业之一，2025 年高端 4K AI 智慧视觉 SoC GK7606V1 系列已量产并导入客户项目量产，普惠型 AI ISP 芯片 GK7206V1 系列已在客户端大批量量产出货，形成了覆盖高中低不同档位细分市场的产品矩阵。在车载电子领域，公司客户对象覆盖整车厂、Tier1 客户、方案公司等，以点线面的策略全面覆盖整个汽车电子产业链，车载 AI 芯片覆盖从 130 万到 800 万像素的摄像头，AI 算力覆盖 0.5TOPS 至 4TOPS，已有多颗芯片通过 AEC-Q100 Grade2 的测试认证。在人工智能领域，公司 AI SoC 系列化产品包括 8TOPS 小算力 AIoT 终端芯片、16TOPS 边缘计算芯片以及预研的 64TOPS 至 128TOPS 大算力芯片，2025 年内合作伙伴生态已覆盖国内主要的端侧大模型公司并形成意向合作。在物联网领域，定位导航芯片已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、测量测绘、安全监测、精准农业、智能穿戴等应用领域，Wi-Fi6 2T2R 无线局域网芯片正在导入 TV、OTT 盒子、商显以及 USB dongle 等领域，部分客户已实现小批量试产。在超高清智能显示领域，公司产品在广电运营商领域已在中国广电有线网络省

分公司导入出货，在 IPTV 机顶盒领域已在中国电信、中国移动、中国联通等运营商侧实现批量出货。丰富的客户储备和成熟的渠道网络，为本次募投项目产品从研发到量产的商业化转化提供了重要的市场保障。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上，公司董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力、巩固市场地位，有利于充实公司资本实力、优化公司资产结构、改善公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日